



南開大學  
Nankai University

计算机学院  
并行程序设计第一次作业

## Apple M1 体系架构调研

姓名：丁屹  
学号：2013280  
专业：计算机科学与技术

2022 年 2 月 26 日

# 目录

<b>1</b>	<b>Apple M1 简述</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>设计</b>	<b>2</b>
2.1	CPU . . . . .	2
2.1.1	对比和分析 . . . . .	3
2.2	GPU . . . . .	4
2.3	其他特性 . . . . .	4
<b>3</b>	<b>性能和效率</b>	<b>4</b>
3.1	Cinebench R23 . . . . .	5
3.2	GeekBench 5 . . . . .	6
<b>4</b>	<b>参考文献</b>	<b>6</b>

# 1 Apple M1 简述

Apple M1 是苹果公司第一款基于 ARM 架构的自研处理器单片系统 (SoC)，为 Mac 产品线与 iPad 产品线提供中央处理器。M1 是首款用于个人电脑的 5 纳米芯片。苹果宣称该芯片在所有低功耗中央处理器产品中性能最佳，同时具有最佳的性能功耗比。

## 2 设计

Apple M1 成为主处理器之前，苹果从 T 系列就开始为迁移 arm 做准备。

### 2.1 CPU

M1 拥有 4 个高性能 “Firestorm” 和 4 个节能 “Icestorm” 核心，提供类似于 ARM DynamIQ 和 Intel 的 Lakefield 和 Alder Lake 处理器的混合配置。这种组合可以实现以前的 Apple-Intel 架构设备无法实现的功耗优化。Apple 声称节能 (high-efficiency) 核心使用的功率是高性能 (high-performance) 核心的十分之一。高性能核心拥有特别大的 192 KB 一级指令缓存和 128 KB 一级数据缓存，并共享一个 12 MB 二级缓存；节能核心具有 128 KB L1 指令高速缓存、64 KB L1 数据高速缓存和共享的 4 MB L2 高速缓存。SoC 还具有由 GPU 共享的 16MB 系统级缓存。

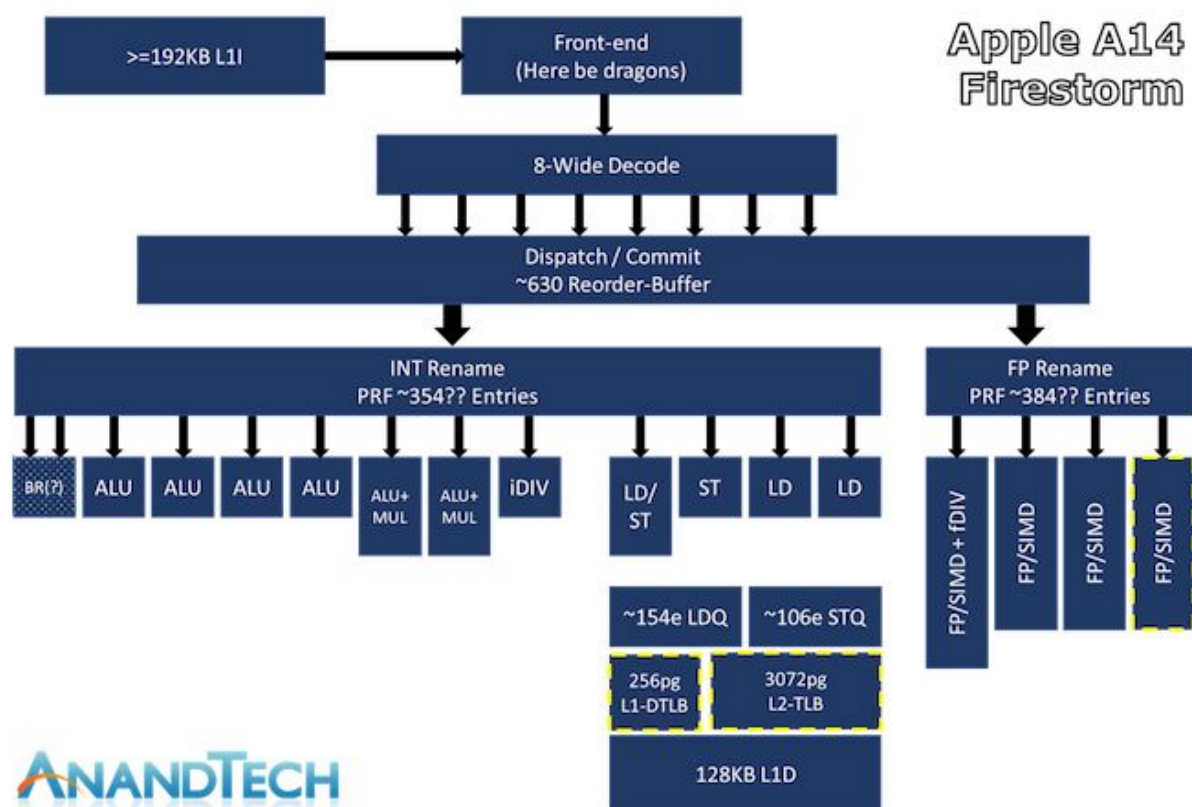
由于苹果公司是一家无厂半导体公司，自身团队专攻芯片设计，最终的芯片制造需要晶圆代工厂来完成。苹果预订了台积电的 5 纳米生产线来制造该款芯片。苹果也是 TSMC 5 纳米生产线的前期客户之一。M1 Pro 和 M1 Max 具有 8 个高性能 “Firestorm” (M1 Pro 的低分档变体中有 6 个) 和 2 个节能的 “Icestorm” 核心，提供总共 10 个核心 (某些核心中有 8 个) 的混合配置 M1 Pro 的基本型号。

- 架构 AArch64
- 指令集架构 ARMv8-A
- 制作工艺/工艺 N5、N5P
- 最大 CPU 加速频率 3.2 GHz
- 核心数量
  - M1 8 ( $4 \times \text{high-performance} + 4 \times \text{high-efficiency}$ )
  - M1 Pro & MAX 10 ( $8 \times \text{high-performance} + 2 \times \text{high-efficiency}$ )
- L1 缓存
  - 192 + 128 KB per core (performance cores)
  - 128 + 64 KB per core (efficient cores)
- L2 缓存
  - 12 MB (performance cores)
  - 4 MB (efficient cores)

CPU	A13-Lightning	A14-FireStorm	Cortex-A77	Cortex-A78	Cortex-X1	Zen2	Zen3	Skylake	Sunny Cove
L1I(KiB)	128	192	64	32/64	64	32	32	32	32
L1D(KiB)	128	128	64	32/64	64	32	32	32	48
L2(MiB)	8	12	0.25/0.5	0.25/0.5	1	0.5	0.5	0.25	0.5
解码宽度	7	8	4	4	5	4	4	5	5
ROB		630	160	160	224	224	256	224	352
Int Reg File		354				180	192	180	
FP Reg File		384				160	160	168	
ALU		6	3	4	4	4	4	4	4
FPU		128bx4	128bx2	128bx2	128bx4	256bx2	256bx2	256bx2	256bx3

表 1: 架构对比

Anandtech 使用 Veedrac 的架构测试软件推测的架构图如下



### 2.1.1 对比和分析

从表1中可以看到，最重要的执行单元部分，M1 / A14 的 6 个 ALU，4 个 FPU 带来的最高理论性能直接就比其它 CPU 高 50% 100%（暂不考虑 x86 256bit 的 AVX）。而 M1 的 L1 / L2 容量、解码宽度、ROB 规模都非常大，往往是其它 CPU 的两三倍（其中 12 MiB 的 L2 容量是四个大核共享，平均 3 MiB / 核心，但运行单线程应用的时候，理论上可以全部由单个核心使用），前端、调度单元、缓存的庞大规模，保证了执行单元能最高效率发挥性能。所以，不考虑更多细节的话，假设大家性能效率发挥基本一致，理论上 M1 的 IPC，整数方面应该比 Zen 2 / 3、SKL、SNC 都高 50%；不考虑 AVX，浮点方面比 Zen 2 / 3、SKL / SNC 高 100%。而 x86 的高频率所必须的长流水线，在分支预测失败需要重新填充流水线的时候，惩罚会比 M1 高，所以实际 IPC 要更低些；Intel 家的 FPU 和 ALU 共享发射端口，IPC 可能会更低一点。

解码器部分，x86 的变长指令解码器需要解析完一条指令得知本条指令长度后，才能计算出下一

条指令的起始地址；在此之前，CPU 无法知道下一条指令从哪里开始，对连续的指令序列无法分拆后并行解码。虽然程序中会有类似跳转 (JMP)、调用 (CALL) 这样的分支指令，其操作数是某条指令的起始地址，另一个解码器可以从该地址开始解码，实现对指令序列进行并行解码。但毕竟程序中这样的指令密度有限，即便 CPU 中有更多的解码器对更多分支的指令并行解码，往往某个解码器解码后的 OPs 在多个时钟周期内也不会进入执行序列。今天的 x86 CPU，AMD 已经是四个复杂解码器，Intel 是一个复杂解码器 + 四个简单解码器，已经有点过于富裕，这也是两家的 CPU 都支持 SMT (Simultaneous MultiThreading, 同时多线程，也就是 Intel 的 Hyper Threading, 超线程)，并且开启 SMT 后多线程性能往往有相当幅度提升的一个重要原因，因为对两个线程并行解码后可以进入执行序列的 OPs 数量更多。

而 RISC 的定长指令，指令抓取单元直接对指令序列按长度分割后，交由不同的解码器并行解码即可。因此可以看到两个超宽的 RISC 架构：IBM 最新的 POWER 可以配置为支持 SMT8，以及虽然不支持 SMT 但 IPC 惊人的苹果 A 系列。在 CISC 的 x86 上则没有出现过类似的超宽架构。

## 2.2 GPU

M1 集成了 Apple 设计的 8 核（在某些基本型号中为七核）图形处理单元 (GPU)。每个 GPU 核心被分成 16 个执行单元，每个执行单元包含 8 个算术逻辑单元 (ALU)。M1 GPU 总共包含多达 128 个执行单元或 1024 个 ALU，Apple 表示它们可以同时执行多达 24,576 个线程，其最大浮点 (FP32) 性能为 2.6 TFLOP。

M1 Pro 集成了 Apple 设计的 16 核（在某些基本型号中为 14 个）图形处理单元 (GPU)，而 M1 Max 则集成了一个 32 核（在某些基本型号中为 24 个）GPU。每个 GPU 核心分为 16 个执行单元，每个执行单元包含 8 个算术逻辑单元 (ALU)。M1 Max GPU 总共包含多达 512 个执行单元或 4096 个 ALU，其最大浮点 (FP32) 性能为 10.4 TFLOP。

## 2.3 其他特性

M1 在处理器所有组件共享的统一内存配置中使用 4,266 MT/s LPDDR4X SDRAM。SoC 和 RAM 芯片以系统级封装设计安装在一起。提供 8 GB 和 16 GB 配置。

M1 在 16 核神经引擎中包含专用的神经网络硬件，每秒能够执行 11 万亿次操作。其他组件包括图像信号处理器 (ISP)、NVMe 存储控制器、Thunderbolt 4 控制器和 Secure Enclave。

支持的编解码器包括 H264 和 H265 (8/10 位，最高 4:4:4)、VP9 和 JPEG。

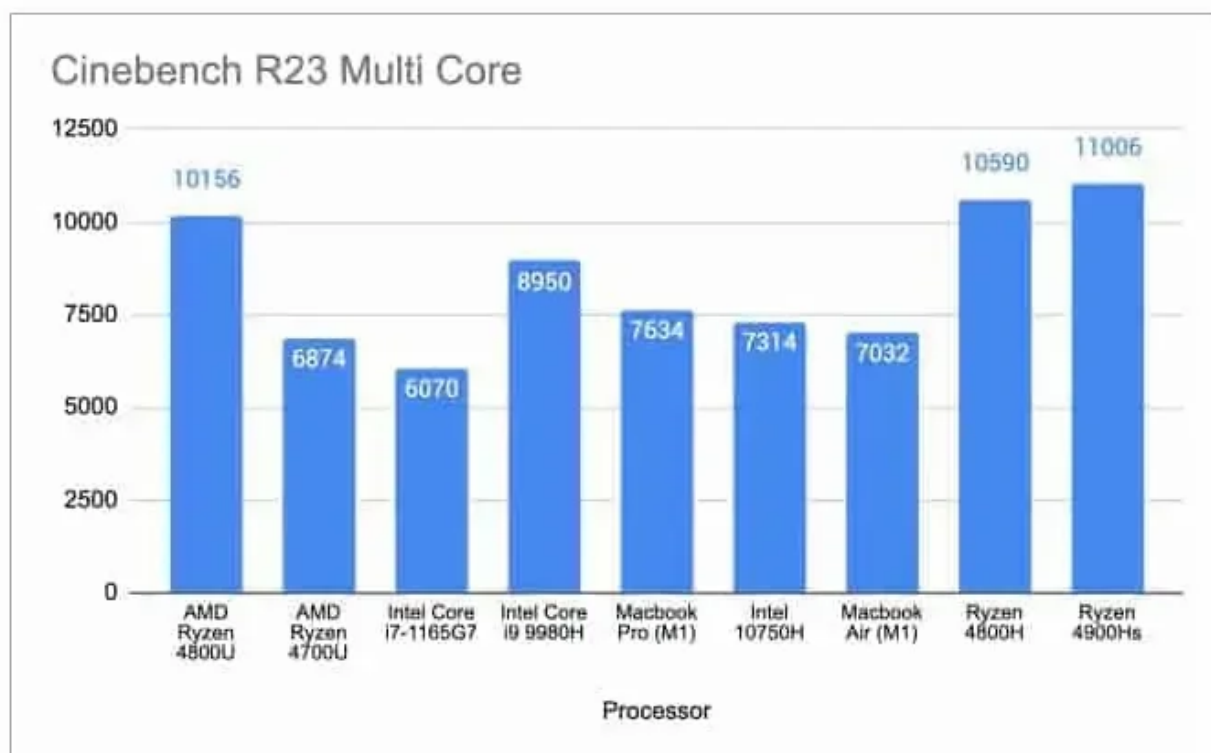
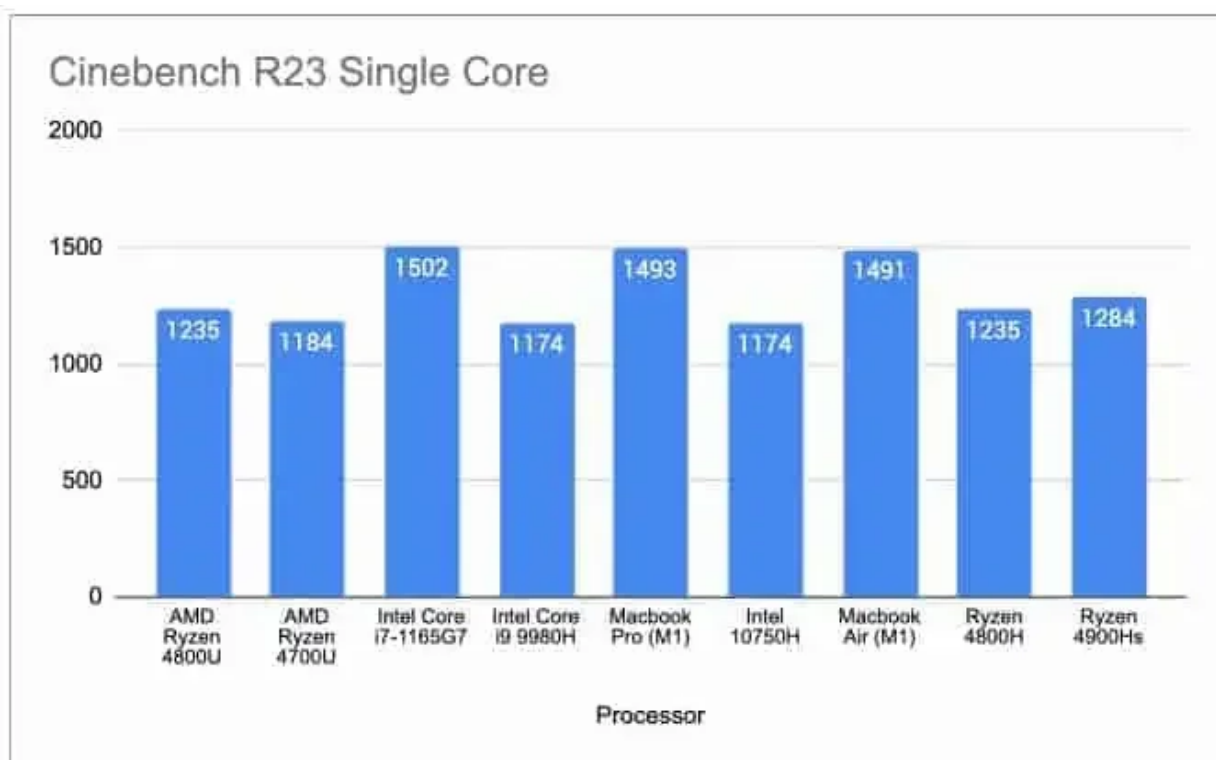
# 3 性能和效率

M1 在流行的基准测试 (Geekbench 5、Cinebench R23) 中记录了具有竞争力的性能和效率。

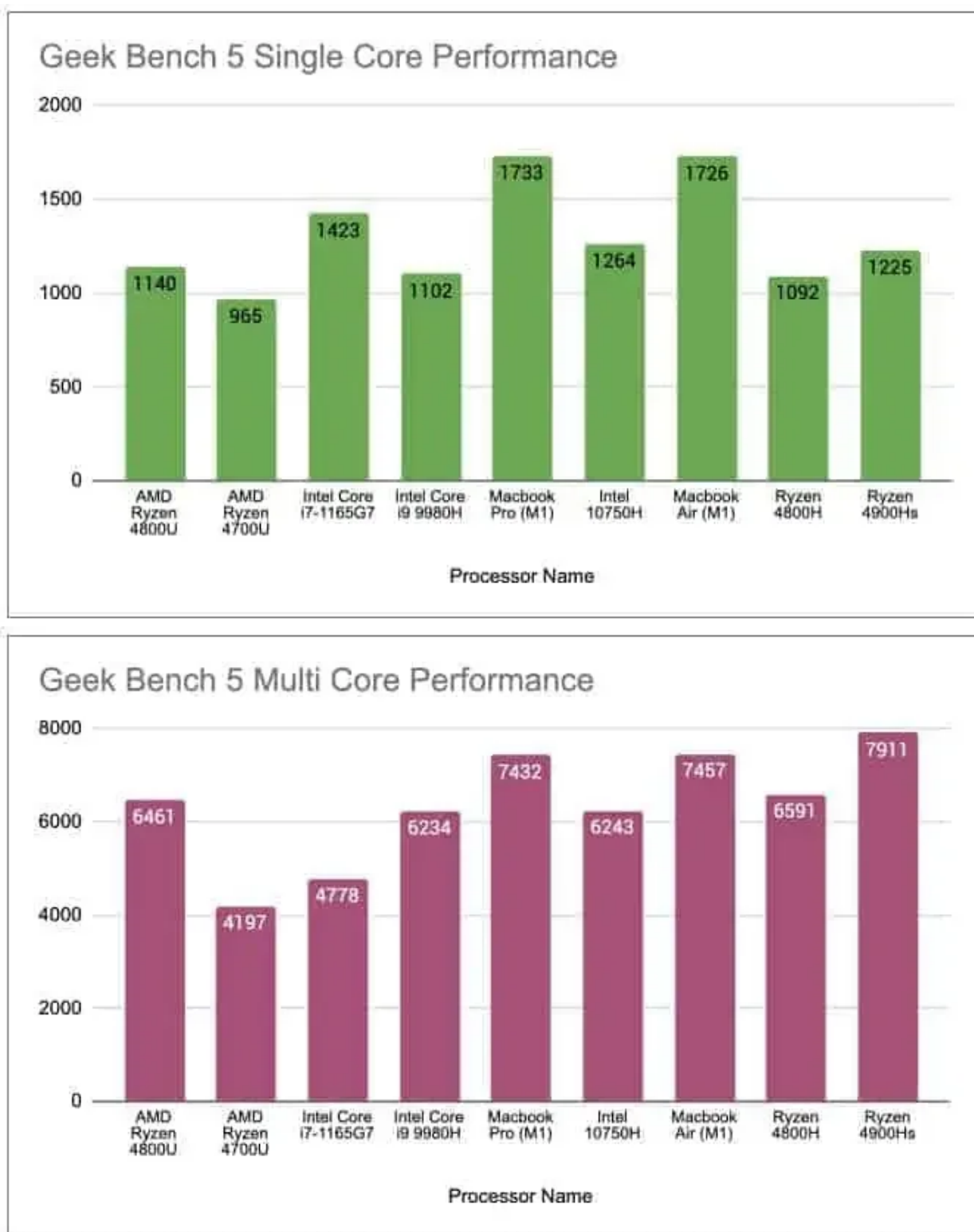
配备 2020 M1 的 Mac mini 在空闲时消耗 7 瓦，在最大负载时消耗 39 瓦，而 2018 年 6 核 Intel i7 Mac mini 的空闲时为 20 瓦，最大负载为 122 瓦。M1 的能效使基于 M1 的 MacBook 的电池寿命比之前基于英特尔的 MacBook 增加了一倍。

在发布时，MacBook Air (M1, 2020) 和 MacBook Pro (M1, 2020) 被认为是 Apple 生产的最快的 MacBook。

### 3.1 Cinebench R23



### 3.2 GeekBench 5



## 4 参考文献

参考文献 [3][1][2]

## 参考文献

- [1] Gene H Golub and James M Ortega. *Scientific computing: an introduction with parallel computing*. Elsevier, 2014.
- [2] Stephen Bassi Joseph, Emmanuel Gbenga Dada, Sanjay Misra, and Samuel Ajoka. Parallel faces recognition attendance system with anti-spoofing using convolutional neural network. In *Illumination of Artificial Intelligence in Cybersecurity and Forensics*, pages 123–137. Springer, 2022.
- [3] Michael J Quinn. *Parallel computing theory and practice*. McGraw-Hill, Inc., 1994.